

The background features a stylized globe with the letters 'GW' in the center, surrounded by circuit-like patterns and binary code. The design is split diagonally, with a greenish-blue upper half and a blue lower half.

# 环球晶圆股份有限公司

**GlobalWafers,  
Global Family,  
Global Solutions!**



**GlobalWafers Co., Ltd.**  
**環球晶圓股份有限公司**

[www.sas-globalwafers.com](http://www.sas-globalwafers.com)

## 愿景



探索科技，环球同行  
致力成为客户的核心技术伙伴

## 使命



环球齐心，未来永续  
整合集团力量，专注全方位服务

## 公司概况

- 创立时间：2011年  
自中美矽晶制品股份有限公司独立分割
- 总部位置：台湾，新竹科学园区
- 产品：提供各式尺寸的晶圆产品
- 员工：7,000人
- 营运据点：遍布亚洲、欧洲及美国

## 独特优势

- 全球第三大，同时也是全球最大的非日系硅晶圆供货商
- 营运据点遍布亚洲、欧洲及美国，提供环球晶圆绝佳的生产弹性及研发技术
- 独特的营运模式及市场优势使环球晶圆自半导体产业链中脱颖而出

### 01 全球布局，稳定供应

- 17 个生产及营运据点  
遍布全球 9 个国家
- 灵活调配全球产能、实现弹性出货

### 02 完整的产品光谱

- 3吋至12吋各式晶圆产品
- 提供客制化产品规格  
满足客户多样化需求

### 03 环境、社会与公司治理(ESG)

负责任的成长是环球晶圆的营运准则，我们致力成为全球标竿，与环境共荣共存

- (E)环境: 追求永续发展
- (S)社会: 致力于互助分享与志愿服务
- (G)公司治理: 实践信息透明、履行诚信经营

诚信



创新



人本



卓群



热忱



GlobalWafers Co., Ltd.  
環球晶圓股份有限公司

# 发展沿革

- 1981  中美矽晶製品股份有限公司  
Sino-American Silicon Products Inc.  
中美矽晶製品股份有限公司成立
- 2008  GLOBITECH  
DESIGNING EPI SOLUTIONS  
收购 GlobiTech Incorporated
- 2011  GlobalWafers Co., Ltd.  
環球晶圓股份有限公司  
中美矽晶將三大事業體獨立分割  
太陽能、半導體、藍寶石  
環球晶圓股份有限公司成立
- 2012 | COVALENT |  
收购 Covalent Silicon Corporation  
(收购日本 Covalent Materials Corp. 子公司半导体硅晶圆相关业务，并更名为 GlobalWafers Japan Co., Ltd.)
- 2015  
環球晶圓股票挂牌上柜
- 2016  TOPSIL  SunEdison  
SEMICONDUCTOR  
收购 Topsil  
收购 SunEdison Semiconductor



## 全球布局

- 广泛且遍布世界的营运据点，能实时服务全球客户
- 在地供应可有效降低长途运输的环境成本，亦减轻地缘政治及总体经济的变动影响

## 产品类别及其应用

01

### 磊芯片

LE 6"  
8"  
12"

车用电子  
功率组件  
MPU / MCU  
CMOS 影像传感器

02

### 抛光片

LE 6"  
8"  
12"

内存  
功率组件  
模拟IC / 逻辑IC  
通讯设备

03

### FZ芯片

LE 6"  
8"

医疗器材  
风力发电  
高速铁路  
车用电子

04

### SiC芯片

LE 6"

车用电子  
高速铁路  
风力发电  
高压功率组件

05

### 退火片

8"  
12"

内存  
液晶驱动器  
模拟IC / 逻辑IC

06

### 扩散片

LE 6"

车用电子  
电力设备  
航天设备

07

### 非抛光芯片

LE 6"

分离式组件

08

### SOI芯片

LE 6"  
8"  
12"

MEMS 传感器  
CMOS  
射频组件  
高压功率组件  
光子组件

09

### GaN/Si, GaN/SiC

LE 6"  
8"

太阳能逆变器  
功率组件  
射频组件

## 产品光谱广泛

• 环球晶圆产品光谱横跨3至12吋，满足客户的全方位需求

• 环球晶圆深化客户研发连结，以掌握市场趋势，生产最新产品

## 深化研发连结 掌握市场脉动

01

### FZ芯片

- 8" 中子照射掺杂(NTD)，应用于高压功率组件
- 8" 气相掺杂(PFZ)，应用于一般功率组件

02

### ECAS

- 无COP缺陷的抛光片  
同时具备高强度与高吸杂能力
- 可广泛运用于内存、影像传感器、3D IC组件

03

### 12" SOI

- RF SOI 搭载高阻基板
- CTL SOI 搭载高阻基板与Charge Trap Layer
- 亦支援光子组件、CMOS影像传感器之相关应用

04

### 宽能隙材料

- 6" n型碳化硅(SiC)抛光片，应用于高压功率组件
- 4" 半绝缘碳化硅(Si SiC)抛光片，应用于高频组件
- 6"/8" 硅晶圆上氮化镓磊晶 (GaN Epi on Si wafer) 于高压高功率及射频组件之应用



GlobalWafers Co., Ltd.  
環球晶圓股份有限公司

# 永续发展

- 负责任的成长是环球晶圆的营运准则
- 环球晶圆致力在环境保护、健康安全与公司治理三大面向成为全球标竿

## 社会面

### 01 互助分享

#### 改变社会

环球晶圆鼓励员工透过回馈社会、关爱弱势群体来传递爱心，以实现更美好的世界。

### 02 志愿服务

#### 善良为首要之务

环球晶圆透过不定期的志工服务，形塑互助与分享的共同目标，以成就更美好的明天。

## 公司治理面

### 01 诚信经营



法令遵循



申诉系统



道德与行为准则



风险评估

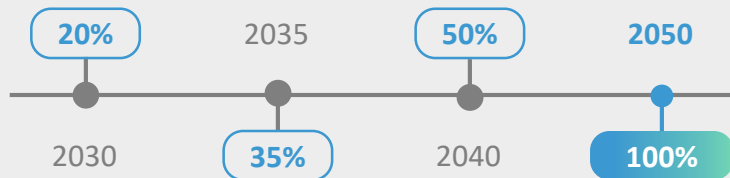
### 02 公司治理

获选台湾公司治理评鉴前百分之五之上柜公司

## 环境面

### 01 承诺于2050年100%使用再生能源

阶段式目标与气候蓝图：



采取措施：



采用再生能源



碳清除



提升能源使用效率



购买碳补偿商品

### 02 水资源回收与再利用



台湾区超过50%的水资源可被回收再利用

### 03 4R 策略

环球晶圆遵循4R策略，实践兼顾生态的循环经济，以完善产线设计、专注源头减量为目标

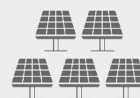
Reduce

Reuse

Recycle

Redesign

### 04 太阳能电厂



环球晶圆兴建太阳能电厂，确保电力供应、扩大绿色能源使用

### 05 废弃物管理

全球厂区超过80%的废弃物皆可回收及再利用



GlobalWafers Co., Ltd.  
环球晶圆股份有限公司





## 让我们一起徜徉 在环球晶圆的世界！

想探索更多环球晶圆吗？  
欢迎浏览环球晶圆官网以了解最新资讯  
( [www.sas-globalwafers.com](http://www.sas-globalwafers.com) )



详细信息  
请至官网查询

30075  
台湾新竹市科学园区工业东二路8号

电话: +886 (3) 5772255  
传真: +886 (3) 5781706



**GlobalWafers Co., Ltd.**  
**環球晶圓股份有限公司**